



Thin Film Planar Filters

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

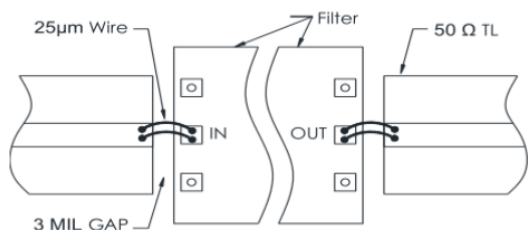
技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数		最小	典型	最大	单位
	中心频率		13.2		GHz
	工作频率	12.4		14.0	GHz
	中心损耗		2.5	3.0	dB
	带内波动		0.8	1.0	dB
	回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-11.5GHz	55	60		dBc
	@15.0-35.0GHz	55	60		dBc

环境要求

最大输入功率	35	dBm
工作温度	-55℃~+85℃	
储存温度	-55℃~+125℃	

推荐装配图



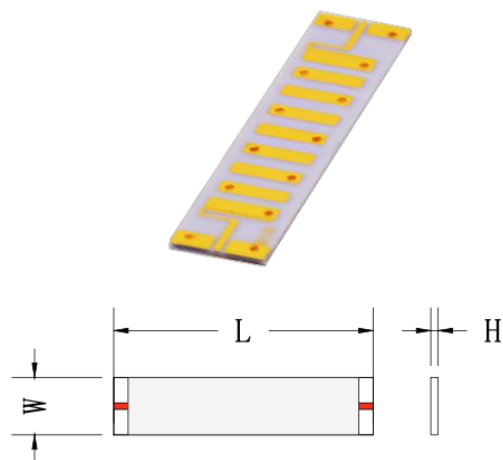
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 **ME8456**)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (**6.7ppm / °C**) ,载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

电路板Rogers5880, h: 0.254mm	电路板Rogers5880, h: 0.127mm

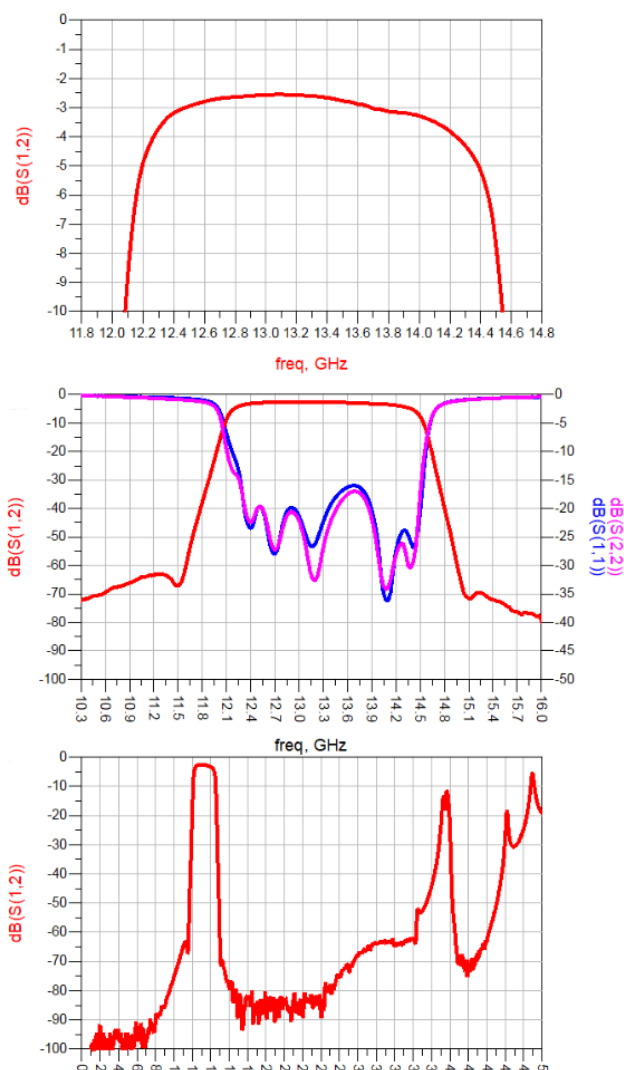
注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



2.0	0.0
-----	-----

024980249802498024980

freq, GHz

Tel:18349127722
Fax:+86 28-80566718

Email:pengxiaojun@cdsprs.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。